

精伦电子股份有限公司

关于收到上交所问询函并回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 13 日收到上海证券交易所《关于对精伦电子股份有限公司签订人脸识别相关合作协议事项的问询函》（上证公函【2016】0498），问询函针对公司 2016 年 5 月 13 日披露的《精伦电子与华中科技大学签署合作协议的公告》内容，认为公司对本次合作协议的关键信息披露不充分，要求公司作出进一步解释和补充，现就问询函内容及相关问题回复如下：

一、公司本次公告未披露合作对方所掌握的“人脸识别技术研究与应用”技术、产业化应用阶段以及不确定性等关键信息，请公司作补充披露：

1. 请披露合作对方目前所掌握的“人脸识别技术研究与应用”合作项目的具体情况，包括技术名称、具体应用领域、是否已申请专利等、是否已开始产业化应用。如果已开始产业化，请说明具体阶段和商用实例；

答：本次合作项目的技术名称为“人脸识别技术”，合作对方目前所掌握的“人脸识别技术”尚未应用到民用领域，需要通过与合作方的协同技术开发实现产品化和商业化。本项技术尚未申请专利，没有开始产业化应用。

2. 若本次合作涉及的相关技术及其产业化运用尚处于试验研发的初级阶段，公司应特别提示相关不确定性和风险。

答：本次合作涉及的相关技术及其产业化运用尚处于试验研发阶段，存在技术指标不达预期以及产业化经济效益不达预期的风险。

二、根据公告，公司根据自身产业布局，一直以来在身份核验智能终端、智能互联及人机交互终端、伺服控制设备、物联网、互联网及云平台技术有一定的技术积累，有完整的市场、设计开发和终端设备制造团队，有丰富的产品实现经验。请公司作补充披露：

1. 结合公司现有的主要产品和技术，具体说明“技术积累”的领域和具体内容，与合作对方所掌握的人脸识别技术研究是实现技术的关联度和整合效应；

答：公司现有产品主要包括身份核验智能终端、智能互联及人机交互终端等，在嵌入式硬件设计、嵌入式软件设计、工业设计等方面有近二十年的积累。搭载公司技术积累的身份核验产品和人机交互产品已经在市场上有广泛应用，市场累计保有量超过数百万台套。与华科大合作后，希望在现有身份核验和人机交互等产品上增加身份证照片和人脸比对等功能，同时也将应用于公司其他商用终端，扩大产品应用领域。公司现有的身份核验产品、智能互联及人机交互产品，均与合作对方所掌握的人脸识别技术研究是实现技术的有较强的关联度和整合效应。

2. 请披露公司进行产业化运用可能存在的主要障碍和不确定性，预计的实现量产并能为公司创造经济效益的时间，并充分作风险提示；

答：公司目前与合作方进行合作技术开发和产业化运用，技术上和目前市场及客户需求分析已经比较充分，并且公司已有自主开发的（同类的）人脸识别初级产品在市场上试用，根据客户反馈和产品需求，与合作方协同技术开发后能更好地丰富公司产品线和满足客户需求，因此不存在产业化运用障碍和不确定性。根据合作计划，预计三个月后进入新品试制阶段，存在的风险包括能够直接产生的经济效益是否达到预期、技术指标是否达到国内领先水平存在不确定性。

3. 该人脸识别技术研究是实现项目是否针对公司现有产品的市场目标地区和客户，还是拟拓展新的市场。若是，请说明公司是否具备相应的计划和能力；

答：该人脸识别技术研究是实现项目针对公司现有产品的市场目标地区和客户，如身份核验和人脸比对双重核验系统、企事业单位和机构考勤系统等。

4. 请披露人脸识别技术研究是实现技术目前在行业内所处的发展阶段，公司是否具备应用该技术、进入该行业的实力，并结合市场竞争格局说明是否具备竞争优势。

答：项目合作方在图像识别领域承担多项国家重大项目，具备深厚的理论水平和技术积累。人脸识别技术理论上已经相当成熟，双方合作主要是产品实现，以及提升识别精度和识别速度。公司在嵌入式系统开发，融合技术创新和商用等方面有多年的积累，现有产品（包括证件核验，指纹识别、掌纹识别、虹膜识别等复合产品）已进入商用和公用等多种场所和领域，有较强的产品实现能力，在人脸识别方面通过对外合作将具备更强的竞争优势。

三、本次公告对签订合作协议的关键信息披露不充分，请依据《上市公司签订战略框架协议公告》格式指引作补充披露：

1. 合作的背景与目标、主要内容、合作模式，双方为执行该框架协议将做的具体工作安排、每项工作的执行时间和预计达到的阶段性成果；

2. 合作规模、开展该合作项目预计的资金需求和资金来源；

3. 合作双方的主要权利和义务划分，协议的生效条件、生效时间，是否存在违约责任。

4. 对相关不确定性作充分的风险提示。

答：已在《精伦电子股份有限公司对外合作补充公告》做补充披露。

特此公告。

精伦电子股份有限公司

董事会

2016年5月14日